

# 義守大學「電子構裝」學程

93 學年度第 2 學期第 2 次教務會議通過(94.06.15)  
95 學年度第 2 學期第 3 次教務會議修正通過(95.12.13)

## 壹、學程目的：

配合政府『兩兆雙星』計畫且國內 IC 構裝產業佔世界第一，有鑑於半導體封裝測試產業需要大量電子、機械、化工、材料等工程專業人才，本學程提供學生技能整合、第二專長的就業能力。

## 貳、發展重點與特色：

本學程以『IC 構裝測試與可靠度分析』為共同核心必修課，另結合電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系的課程，培育學生對半導體構裝技術與發展的認知。

參、實施對象：本校理工學院、電資學院二至四年級學生。

## 肆、課程系統：

- 一、本學程共需修滿十八學分始得發給證書。
- 二、如為電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系之學生，於其主修學系最多修習九學分，其餘學分需於外系開設之課程中選讀。

伍、學程開始日期：九十四學年度。

陸、申請日期：依學校行事曆規定提出申請。

柒、申請程序：先向原肄業學系提出申請，經原學系系主任核准後，再提送本學程委員會審核，通過後送機械與自動化工程學系登記。(審核辦法另訂之)

捌、修習證書：學生修畢應修課程且成績及格者，由學程委員會審查確認，並請理工學院、電資學院院長共同頒發證書，證書記載所修習課程科目。

## 玖、主辦單位：

本學程委員會，每學期至少開會一次，共同規劃、討論、議決學程相關事宜。本學程委員會之委員由機械與自動化工程學系系主任為召集人，電子工程學系系主任、化學工程學系系主任及材料科學與工程學系系主任共同擔任委員，共計四人。

97 學年度「電子構裝」學程課程表

課程分類	課程名稱	必/ 選修	學 分	開課系所	備註
基礎課程 (八選二)	電路學(一)	選	3	電子系	
	電子學(一)	選	3	電子系	
	材料力學	選	3	機動系	
	熱傳學	選	3	機動系	
	有機化學(一)	選	3	化工系	
	化工熱力學(一)	選	3	化工系	
	材料科學導論(一)	選	3	材料系	
	高分子材料概論	選	3	材料系	96 學年度異動學期為上下均開課
專業核心 (一科)	IC 構裝測試與可靠度分析	必	3	機動系	模組化課程，由校內教師與校外實務專家共同授課，視為外系課程。
專業進階 (十五選三)	電子構裝技術	選	3	電子系	
	構裝及基板電腦輔助設計分析	選	3	電子系	
	電子系統冷卻技術	選	3	機動系	
	IC 構裝原理與實務	選	3	機動系	
	高分子材料物性	選	3	材料系	96 學年度起新增
	材料破損分析	選	3	材料系	96 學年度起新增
	積體電路封裝材料與實務	選	3	化工系	96 學年度起學期異動
	※半導體元件製程	選	3	電子系	此四門課為四選一課程。
	※半導體製程	選	3	機動系	
	※半導體製程	選	3	化工系	
	※半導體製程技術	選	3	材料系	
	◎高分子加工與物性	選	3	化工系	「高分子加工與物性」此門課從 96 學年度起學期異動。 此兩門課為二選一課程。
◎高分子材料加工原理與應用	選	3	材料系		

96 學年度起停開課程：

材料系：半導體封裝概論、高分子電子材料、半導體封裝製程與材料、液晶顯示器之驅動 IC 相關封裝材料及可靠度介紹。